

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

#4

5-8-02

Maish

Docket No.: 50090-466

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Hiroshi HORIBE

Serial No.:

Group Art Unit:

Filed: January 18, 2002

Examiner:

For: SEMICONDUCTOR DEVICE AND WIRE BONDING APPARATUS



**CLAIM OF PRIORITY AND
TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicant hereby claims the priority of:

Japanese Patent Application No. 2001-256892, filed August 27, 2001

cited in the Declaration of the present application. A certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Becker".

Stephen A. Becker
Registration No. 26,527

600 13th Street, N.W.
Washington, DC 20005-3096
(202) 756-8000 SAB:mlw
Date: January 18, 2002
Facsimile: (202) 756-8087

9,536 us
50090-466
Hirashi HORIBE
January 18, 2002
McDermott, Will & Emery

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 8月27日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-256892

出 願 人

Applicant(s):

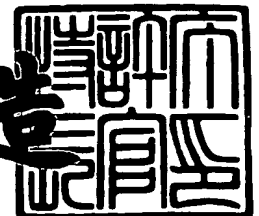
三菱電機株式会社



2001年 9月 6日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3082536

【書類名】 特許願

【整理番号】 533675JP01

【提出日】 平成13年 8月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/60

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社
社内

【氏名】 堀部 裕史

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100082175

【弁理士】

【氏名又は名称】 高田 守

【電話番号】 03-5379-3088

【選任した代理人】

【識別番号】 100066991

【弁理士】

【氏名又は名称】 葛野 信一

【電話番号】 03-5379-3088

【選任した代理人】

【識別番号】 100106150

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 英樹

【電話番号】 03-5379-3088

【選任した代理人】

【識別番号】 100108372

【弁理士】

【氏名又は名称】 谷田 拓男

【電話番号】 03-5379-3088

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 049397

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置及びワイヤボンディング装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 チップ上に配列された複数のボンディングパッドと、上記ボンディングパッドに対向して配列された複数のインナーリードとが、それぞれボンディングワイヤにて電氣的に接続された半導体装置であって、

上記ボンディングワイヤは、上記チップ上の導電部に対して電氣的に絶縁された複数の屈曲部を備えるとともに、上記ボンディングパッドを上記チップ上における外周部から中央部にかけての任意の位置に配置可能に形成されたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 上記屈曲部は、上記チップから離れた位置に形成されることで上記チップ上の導電部に対して電氣的に絶縁されたことを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】 上記チップは、表面に電氣的絶縁部を備え、

上記複数の屈曲部のうち少なくとも 1 つの屈曲部は、上記チップ上の電氣的絶縁部に当接することで上記チップ上の導電部に対して電氣的に絶縁されたことを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の半導体装置。

【請求項 4】 上記チップ及び上記複数のインナーリードは、封止樹脂により封止され、

上記複数の屈曲部のうち少なくとも 1 つの屈曲部が上記封止樹脂の表面に露呈するように、上記ボンディングワイヤが上記封止樹脂に封止されたことを特徴とする請求項 1 ～請求項 3 のいずれかに記載の半導体装置。

【請求項 5】 上記ボンディングワイヤの上記複数の屈曲部のうち上記インナーリード側に近設する屈曲部は、上記チップ上の領域から外れて上記インナーリード側に設けられたことを特徴とする請求項 1 ～請求項 4 のいずれかに記載の半導体装置。

【請求項 6】 上記ボンディングワイヤの上記複数の屈曲部のうち上記インナーリード側に近設する屈曲部は、上記チップ側に近設する屈曲部より高い位置に設けられたことを特徴とする請求項 1 ～請求項 5 のいずれかに記載の半導体装

置。

【請求項 7】 請求項 1～請求項 6 のいずれかに記載の半導体装置を製造することを特徴とするワイヤボンディング装置。

【請求項 8】 チップ上に配列された複数のボンディングパッドと、リードフレーム上に配列された複数のインナーリードとを、それぞれボンディングワイヤにて電氣的に接続するワイヤボンディング装置であって、

上記チップ主面方向からみた上記ボンディングワイヤにおける上記ボンディングパッドから上記インナーリードに至るワイヤ全長に対する比率を設定して、上記チップ上の導電部に対して電氣的に絶縁される複数の屈曲部を上記比率に応じて上記ボンディングワイヤに形成することを特徴とするワイヤボンディング装置。

【請求項 9】 上記屈曲部を形成する際の上記屈曲部の位置ずれ量についての情報を保持し、上記屈曲部の位置ずれ量に応じて上記ボンディングワイヤのワイヤ全長を補正することを特徴とする請求項 8 に記載のワイヤボンディング装置。

【請求項 10】 上記ボンディングワイヤの上記ワイヤ全長の補正は、上記屈曲部の位置ずれ量の絶対値を上記ワイヤ全長に加減するものであることを特徴とする請求項 9 に記載のワイヤボンディング装置。

【請求項 11】 上記ボンディングワイヤの上記ワイヤ全長の補正は、上記屈曲部の位置ずれ量を上記屈曲部の上記ワイヤ全長に対する比率で除した値を、上記ワイヤ全長に加減するものであることを特徴とする請求項 9 に記載のワイヤボンディング装置。

【請求項 12】 上記チップ主面方向からみた上記ボンディングワイヤにおける上記ボンディングパッドから上記チップ端面に至るチップ上ワイヤ長を算出した後に、上記複数の屈曲部を形成することを特徴とする請求項 8～請求項 11 のいずれかに記載のワイヤボンディング装置。

【請求項 13】 上記チップ上ワイヤ長は、上記チップ主面方向からみた上記チップの寸法と、上記チップ主面方向からみた上記ボンディングワイヤの両端の座標とから算出することを特徴とする請求項 12 に記載のワイヤボンディング

装置。

【請求項 1 4】 上記リードフレーム上のダイパッドに搭載される上記チップの位置ずれを検出する検出部を備え、

上記検出部によって検出した上記チップの位置ずれ量に基づき上記チップ上ワイヤ長の算出結果の調整をすることを特徴とする請求項 1 2 又は請求項 1 3 に記載のワイヤボンディング装置。

【請求項 1 5】 上記チップ上ワイヤ長に対して予め設定値を定め、

上記チップ上ワイヤ長の算出結果と上記設定値とを対比した結果に基づき、上記ボンディングワイヤの操作方向を切換えることを特徴とする請求項 1 2 ～請求項 1 4 のいずれかに記載のワイヤボンディング装置。

【請求項 1 6】 上記ボンディングワイヤは、上記ボンディングパッドを上記チップ上における外周部から中央部にかけての任意の位置に配置可能に形成されることを特徴とする請求項 8 ～請求項 1 5 のいずれかに記載のワイヤボンディング装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

この発明は、半導体装置及びワイヤボンディング装置に関し、特に、チップ表面の位置がインナーリード表面の位置よりも高く形成された双方の表面をワイヤボンディングした半導体装置及びそれを製造するワイヤボンディング装置に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来より、半導体装置におけるチップの開発効率を高めて、低廉かつ安定した半導体装置を提供することが求められている。

半導体装置のチップは、その内部に回路部が集積されている。そして、チップ内部の回路部とチップ外部との電気信号のやり取りを行うために、複数のボンディングパッドがチップ表面に配置されている。

半導体装置の製造工程において、チップは、リードフレーム上のダイパッド（

アイランド部)に搭載される。一方、リードフレーム上のダイパッドの周囲には、複数のインナーリードがボンディングパッドに対向するように配置される。

そして、ワイヤボンディング装置にて、複数のインナーリードと、チップ上の複数のボンディングパッドとを、それぞれボンディングワイヤ(金属ループ)により電氣的に接続する。

そして、ワイヤボンディング装置によるボンディングワイヤの接続が終了した後に、チップ、インナーリード、ボンディングワイヤが、封止樹脂(パッケージ)により封止される。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

上述の従来の半導体装置においては、ボンディングパッドをチップ表面の外周部に配置するという制約があり、半導体装置の開発効率を飛躍的に高めることが難しかった。

詳しくは、ボンディングワイヤがチップ端面に接触すると、チップとボンディングワイヤとの短絡を生ずる可能性がある。したがって、ボンディングワイヤとチップとの接触を避けるために、ボンディングパッドを、チップ表面の中央部には配列せずに、チップ表面の外周部に配列していた。このことは、チップ内部の回路部のレイアウトにも、一定の制約を与えることになっていた。すなわち、チップ外周部に配置されるボンディングパッドに合わせて、回路部のレイアウトを行う必要があった。

【0004】

この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、チップ内部の回路部のレイアウトの自由度が高くて、開発効率の高い半導体装置及びワイヤボンディング装置を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】

この発明の請求項1記載の発明にかかる半導体装置は、チップ上に配列された複数のボンディングパッドと、上記ボンディングパッドに対向して配列された複数のインナーリードとが、それぞれボンディングワイヤにて電氣的に接続された

半導体装置であって、上記ボンディングワイヤは、上記チップ上の導電部に対して電氣的に絶縁された複数の屈曲部を備えるとともに、上記ボンディングパッドを上記チップ上における外周部から中央部にかけての任意の位置に配置可能に形成されたものである。

【 0 0 0 6 】

また、請求項 2 記載の発明にかかる半導体装置は、上記請求項 1 記載の発明において、上記屈曲部は、上記チップから離れた位置に形成されることで上記チップ上の導電部に対して電氣的に絶縁されたものである。

【 0 0 0 7 】

また、請求項 3 記載の発明にかかる半導体装置は、上記請求項 1 又は請求項 2 に記載の発明において、上記チップは、表面に電氣的絶縁部を備え、上記複数の屈曲部のうち少なくとも 1 つの屈曲部は、上記チップ上の電氣的絶縁部に当接することで上記チップ上の導電部に対して電氣的に絶縁されたものである。

【 0 0 0 8 】

また、請求項 4 記載の発明にかかる半導体装置は、上記請求項 1 ～請求項 3 のいずれかに記載の発明において、上記チップ及び上記複数のインナーリードは、封止樹脂により封止され、上記複数の屈曲部のうち少なくとも 1 つの屈曲部が上記封止樹脂の表面に露呈するように、上記ボンディングワイヤが上記封止樹脂に封止されたものである。

【 0 0 0 9 】

また、請求項 5 記載の発明にかかる半導体装置は、上記請求項 1 ～請求項 4 のいずれかに記載の発明において、上記ボンディングワイヤの上記複数の屈曲部のうち上記インナーリード側に近設する屈曲部は、上記チップ上の領域から外れて上記インナーリード側に設けられたものである。

【 0 0 1 0 】

また、請求項 6 記載の発明にかかる半導体装置は、上記請求項 1 ～請求項 5 のいずれかに記載の発明において、上記ボンディングワイヤの上記複数の屈曲部のうち上記インナーリード側に近設する屈曲部は、上記チップ側に近設する屈曲部より高い位置に設けられたものである。

【0011】

また、この発明の請求項7記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、請求項1～請求項6のいずれかに記載の半導体装置を製造するものである。

【0012】

また、この発明の請求項8記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、チップ上に配列された複数のボンディングパッドと、リードフレーム上に配列された複数のインナーリードとを、それぞれボンディングワイヤにて電氣的に接続するワイヤボンディング装置であって、上記チップ主面方向からみた上記ボンディングワイヤにおける上記ボンディングパッドから上記インナーリードに至るワイヤ全長に対する比率を設定して、上記チップ上の導電部に対して電氣的に絶縁される複数の屈曲部を上記比率に応じて上記ボンディングワイヤに形成するものである。

【0013】

また、請求項9記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、上記請求項8記載の発明において、上記屈曲部を形成する際の上記屈曲部の位置ずれ量についての情報を保持し、上記屈曲部の位置ずれ量に応じて上記ボンディングワイヤのワイヤ全長を補正するものである。

【0014】

また、請求項10記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、上記請求項9記載の発明において、上記ボンディングワイヤの上記ワイヤ全長の補正は、上記屈曲部の位置ずれ量の絶対値を上記ワイヤ全長に加減するものである。

【0015】

また、請求項11記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、上記請求項9記載の発明において、上記ボンディングワイヤの上記ワイヤ全長の補正は、上記屈曲部の位置ずれ量を上記屈曲部の上記ワイヤ全長に対する比率で除した値を、上記ワイヤ全長に加減するものである。

【0016】

また、請求項12記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、上記請求項8～請求項11のいずれかに記載の発明において、上記チップ主面方向からみた

上記ボンディングワイヤにおける上記ボンディングパッドから上記チップ端面に至るチップ上ワイヤ長を算出した後に、上記複数の屈曲部を形成するものである。

【 0 0 1 7 】

また、請求項 1 3 記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、上記請求項 1 2 記載の発明において、上記チップ上ワイヤ長は、上記チップ主面方向からみた上記チップの寸法と、上記チップ主面方向からみた上記ボンディングワイヤの両端の座標とから算出するものである。

【 0 0 1 8 】

また、請求項 1 4 記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、上記請求項 1 2 又は請求項 1 3 に記載の発明において、上記リードフレーム上のダイパッドに搭載される上記チップの位置ずれを検出する検出部を備え、上記検出部によって検出した上記チップの位置ずれ量に基づき上記チップ上ワイヤ長の算出結果の調整をするものである。

【 0 0 1 9 】

また、請求項 1 5 記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、上記請求項 1 2 ～請求項 1 4 のいずれかに記載の発明において、上記チップ上ワイヤ長に対して予め設定値を定め、上記チップ上ワイヤ長の算出結果と上記設定値とを対比した結果に基づき、上記ボンディングワイヤの操作方向を切換えるものである。

【 0 0 2 0 】

また、請求項 1 6 記載の発明にかかるワイヤボンディング装置は、上記請求項 8 ～請求項 1 5 のいずれかに記載の発明において、上記ボンディングワイヤは、上記ボンディングパッドを上記チップ上における外周部から中央部にかけての任意の位置に配置可能に形成されるものである。

【 0 0 2 1 】

【発明の実施の形態】

以下に、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、各図中、同一または相当する部分には同一の符号を付しており、その重複説明は適宜に簡略化ないし省略する。

【 0 0 2 2 】

実施の形態 1.

以下、この発明の実施の形態 1 を図面に基づいて詳細に説明する。図 1 は、この発明の実施の形態 1 を示す半導体装置の概略図である。図 1 において、1 はダイパッド、2 は内部に回路部を備えとともにダイパッド 1 上に設置されるチップ、2 a はチップ 2 の表面（主面）、3 はチップ 2 上（表面 2 a）に配置されるボンディングパッド、3 a はボンディングパッド 3 の表面、4 はボンディングパッド 3 に対向して配置されるインナーリード、4 a はインナーリード 4 の表面、5 はボンディングパッド 3 とインナーリード 4 とを電氣的に接続するボンディングワイヤ（金属ループ）、K 1 ～K 4 はボンディングワイヤ 5 の屈曲部（屈曲点）を示す。

【 0 0 2 3 】

なお、同図において、チップ 2 上には複数のボンディングパッド 3 が配置され、それに対向する複数のインナーリード 4 が配置され、さらに、それらにはそれぞれボンディングワイヤ 5 が接続されるが、簡単のためそれら複数の部材の図示を省略して、単数の部材の図示とした。

【 0 0 2 4 】

ここで、ボンディングワイヤ 5 には、ボンディングパッド 3 側から、屈曲部 K 1、K 2、K 3、K 4 が順次形成されている。この複数の屈曲部 K 1 ～K 4 は、連続した一本のボンディングワイヤ 5 を折り曲げて形成したものであり、ラーメン構造体の節点と同様の機能を果たす。すなわち、ボンディングワイヤ 5 にかかる外力に対する強度が増すために、その姿勢を容易に保持することができる。

【 0 0 2 5 】

また、屈曲部 K 1 ～K 4 は、いずれも、チップ 2 の表面 2 a から離れた位置に形成される。これにより、屈曲部 K 1 ～K 4 は、チップ 2 上の導電部に対して電氣的に絶縁される。すなわち、屈曲部 K 1 ～K 4 とチップ 2 とは、短絡しない位置関係にある。

さらに、複数の屈曲部 K 1 ～K 4 のうちインナーリード 4 側に近設する屈曲部 K 4 は、チップ 2 上の領域 D を外れて、距離 D 1 だけインナーリード 4 側に設け

られる。すなわち、屈曲部 K 4 は、チップ 2 の端面（チップエッジ）よりもインナーリード 4 側に形成される。

【 0 0 2 6 】

他方、複数のボンディングパッド 3 は、チップ 2 の表面 2 a における外周部から中央部にかけて、点在するように配置されている。すなわち、チップ 2 内部の回路部の自由なレイアウトに対応して、ボンディングパッド 3 が中央部に配置されたり、外周部に配置されたりする。

なお、図 1 においては、ボンディングパッド 3 は、チップ 2 のほぼ中央部に配置されている。ここで、ボンディングパッド 3 をチップ 2 の中央部に配置した場合に、チップ主面方向（表面 2 a の上方である。）からみて、ボンディングワイヤ 5 のワイヤ全長に対する、ボンディングワイヤ 5 のチップ 2 上の長さ（チップ上ワイヤ長）は、30%程度になる。

【 0 0 2 7 】

以上のように構成された半導体装置は、その後、封止樹脂にて封止されることになる。このとき、ボンディングワイヤ 5 は、上述した屈曲部 K 1 ～ K 4 の作用により、封止時の封止樹脂の圧力を受けても、その姿勢をほとんど変化させない。

こうして完成した半導体装置において、ボンディングワイヤ 5、インナーリード 4 を介して、チップ 2 内部の回路部とチップ 2 外部との間で、電気信号のやり取りが行われる。

【 0 0 2 8 】

以上説明したように、本実施の形態 1 のように構成された半導体装置においては、機械的強度の高いボンディングワイヤ 5 にて、ボンディングワイヤ 5 とチップ 2 との短絡を確実に防止しながら、ボンディングパッド 3 をチップ 2 上の任意の位置に配置可能としたので、チップ 2 内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

【 0 0 2 9 】

なお、本実施の形態 1 に示す半導体装置は、ワイヤボンディング装置によって製造されるものである。すなわち、ワイヤボンディング装置の操作によって、ボ

ンディングワイヤ5に屈曲部K1～K4を形成しながら、ボンディングワイヤ5がボンディングパッド3の表面3aからインナーリード4の表面4aへと、又は、インナーリード4の表面4aからボンディングパッド3の表面3aへと接続される。

また、本実施の形態1においては、ボンディングワイヤ5に4つの屈曲部K1～K4を形成したが、この屈曲部の数はこれに限定されることはない。

【0030】

実施の形態2.

以下、この発明の実施の形態2を図面に基づいて詳細に説明する。図2は、この発明の実施の形態2を示す半導体装置の概略図である。本実施の形態2は、インナーリード4側に近設する屈曲部K4の配置が、前記実施の形態1と相違する。

図2において、1はダイパッド、2はチップ、3はボンディングパッド、4はインナーリード、5はボンディングワイヤ、K1～K4はボンディングワイヤ5の屈曲部を示す。

【0031】

ここで、前記実施の形態1と同様に、ボンディングワイヤ5には、ボンディングパッド3側から、屈曲部K1、K2、K3、K4が順次形成されている。そして、インナーリード4側に近設する屈曲部K4は、チップ2側に近設する屈曲部K1より高い位置に形成されている。すなわち、チップ2の表面2aを基準として、インナーリード4側の屈曲部K4の高さは、チップ2側の屈曲部K1の高さHに対して、高さH1だけ高くなるように形成される。

【0032】

また、屈曲部K1～K4は、いずれも、チップ2の表面2aから離れた位置に形成されて、チップ2上の導電部に対して電氣的に絶縁される。

他方、ボンディングパッド3は、チップ2の表面2aにおける外周部から中央部にかけての全面に自在に配置されている。

以上のように構成された半導体装置は、その後、封止樹脂にて封止されることになる。

【 0 0 3 3 】

以上説明したように、本実施の形態 2 のように構成された半導体装置においては、前記実施の形態 1 と同様に、機械的強度の高いボンディングワイヤ 5 にて、ボンディングワイヤ 5 とチップ 2 との短絡を確実に防止しながら、ボンディングパッド 3 をチップ 2 上の自由な位置に配置可能としたので、チップ 2 内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

【 0 0 3 4 】

実施の形態 3.

以下、この発明の実施の形態 3 を図面に基づいて詳細に説明する。図 3 は、この発明の実施の形態 3 を示す半導体装置の概略図である。本実施の形態 3 は、複数の屈曲部 K 1 ~ K 4 のうち 1 つの屈曲部 K 2 の配置が、前記各実施の形態と相違する。

図 3 において、1 はダイパッド、2 はチップ、2 a 1 はチップ 2 の表面 2 a に形成された電氣的絶縁部、3 はボンディングパッド、4 はインナーリード、5 はボンディングワイヤ、K 1 ~ K 4 はボンディングワイヤ 5 の屈曲部を示す。

【 0 0 3 5 】

ここで、前記各実施の形態と同様に、ボンディングワイヤ 5 には、ボンディングパッド 3 側から、屈曲部 K 1、K 2、K 3、K 4 が順次形成されている。そして、複数の屈曲部 K 1 ~ K 4 のうち中間に配置される屈曲部 K 2 は、チップ 2 上の電氣的絶縁部 2 a 1 に当接している。ここで、電氣的絶縁部 2 a 1 とは、例えば、チップ 2 上の一部に形成される絶縁フィルムである。

これに対して、その他の屈曲部 K 1、K 3、K 4 については、チップ 2 の表面 2 a から離れた位置に形成されている。

このように、すべての屈曲部 K 1 ~ K 4 について、チップ 2 上の導電部に対して電氣的に絶縁されるので、チップ 2 と短絡を生じることはない。

【 0 0 3 6 】

他方、ボンディングパッド 3 は、チップ 2 の表面 2 a における外周部から中央部にかけての全面に自在に配置されている。

以上のように構成された半導体装置は、その後、封止樹脂にて封止されること

になる。

【 0 0 3 7 】

以上説明したように、本実施の形態 3 のように構成された半導体装置においては、前記各実施の形態と同様に、機械的強度の高いボンディングワイヤ 5 にて、ボンディングワイヤ 5 とチップ 2 との短絡を確実に防止しながら、ボンディングパッド 3 をチップ 2 上の任意の位置に配置可能としたので、チップ 2 内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

【 0 0 3 8 】

特に、本実施の形態 3 においては、ボンディングワイヤ 5 の屈曲部 K 2 がチップ 2 の表面 2 a に当接しているので、ボンディングワイヤ 5 が両端と中間部の 3 点で支持されることになる。したがって、ボンディングワイヤ 5 の構造体としての強度は、前記各実施の形態と比較して、一層向上する。

なお、本実施の形態 3 では、屈曲部 K 2 のみをチップ 2 の電氣的絶縁部 2 a 1 に当接させたが、電氣的絶縁部 2 a 1 に当接させる屈曲部の位置、数等はこれに限定されることはない。

【 0 0 3 9 】

実施の形態 4 .

以下、この発明の実施の形態 4 を図面に基づいて詳細に説明する。図 4 は、この発明の実施の形態 4 を示す半導体装置の概略図である。本実施の形態 4 は、複数の屈曲部 K 1 ~ K 4 のうち 1 つの屈曲部 K 4 の配置が、前記各実施の形態と相違する。

図 4 において、1 はダイパッド、2 はチップ、3 はボンディングパッド、4 はインナーリード、5 はボンディングワイヤ、6 はチップ 2、インナーリード 4 等を封止する封止樹脂（パッケージ）、6 a は封止樹脂 6 の表面、K 1 ~ K 4 はボンディングワイヤ 5 の屈曲部を示す。

【 0 0 4 0 】

ここで、前記各実施の形態と同様に、ボンディングワイヤ 5 には、ボンディングパッド 3 側から、屈曲部 K 1、K 2、K 3、K 4 が順次形成されている。そして、複数の屈曲部 K 1 ~ K 4 のうちインナーリード 4 側の屈曲部 K 4 は、封止樹

脂 6 の表面 6 a から露呈するように形成されている。

これに対して、その他の屈曲部 K 1 ～ K 3 は、封止樹脂 6 の表面 6 a から露呈することなく、封止樹脂 6 内部に形成されている。

【 0 0 4 1 】

このように、すべての屈曲部 K 1 ～ K 4 について、チップ 2 上の導電部に対して電氣的に絶縁されるので、チップ 2 と短絡を生じることはない。

他方、ボンディングパッド 3 は、チップ 2 の表面 2 a における外周部から中央部にかけての全面に自在に配置されている。

【 0 0 4 2 】

以上説明したように、本実施の形態 4 のように構成された半導体装置においては、前記各実施の形態と同様に、機械的強度の高いボンディングワイヤ 5 にて、ボンディングワイヤ 5 とチップ 2 との短絡を確実に防止しながら、ボンディングパッド 3 をチップ 2 の表面 2 a に自由に配置可能としたので、チップ 2 内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

【 0 0 4 3 】

特に、本実施の形態 4 においては、ボンディングワイヤ 5 の屈曲部 K 4 が封止樹脂 6 の表面 6 a から露呈しているので、樹脂を金型内に流し込む過程における、ボンディングワイヤ 5 にかかる樹脂の圧力を部分的に軽減することができる。したがって、ボンディングワイヤ 5 の構造体は、その姿勢を一層保持することができる。

なお、本実施の形態 4 では、屈曲部 K 4 のみを封止樹脂 6 の表面 6 a から露呈させたが、封止樹脂 6 の表面 6 a から露呈させる屈曲部の位置、数等はこれに限定されることはない。

【 0 0 4 4 】

実施の形態 5.

以下、この発明の実施の形態 5 を図面に基づいて詳細に説明する。図 5 は、この発明の実施の形態 5 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。

図 5 において、1 は図示せぬリードフレーム上に設置されるダイパッド、2 は

チップ、3はボンディングパッド、4はボンディングパッド3に対向するようにリードフレーム上に設置されるインナーリード、5はボンディングワイヤ、K1～K4はボンディングワイヤ5の屈曲部を示す。

【0045】

なお、本実施の形態5のワイヤボンディング装置は、ボンディングワイヤ5が巻線されたスプール部、スプール部から供給されるボンディングワイヤ5を所定方向に案内する管部、管部を操作する操作部、操作部を制御する制御部等で構成されるが、簡単のためそれらの図示を省略する。

そして、ワイヤボンディング装置により、ボンディングワイヤ5が、ボンディングパッド3からインナーリード4へと接続される。

【0046】

その際、管部の階段状の移動により、ボンディングワイヤ5には、ボンディングパッド3側から、屈曲部K1、K2、K3、K4が順次形成される。

詳しくは、屈曲部K1～K4を形成するために、チップ2主面方向からみた、ボンディングパッド3からインナーリード4に至るワイヤ全長ALに対する比率を設定して、その設定値をワイヤボンディング装置の入力部に入力する。そして、その設定値に基づいて、ワイヤボンディング装置の管部が移動する。これにより、ボンディングワイヤ5におけるチップ2側の端部を基準として、距離L1の位置に屈曲部K1が、距離L2の位置に屈曲部K2が、距離L3の位置に屈曲部K3が、距離L4の位置に屈曲部K4が、それぞれ形成されることになる。

【0047】

以上のようにワイヤボンディング装置により形成された屈曲部K1～K4は、いずれも、チップ2上から離れた位置に形成されて、チップ2上の導電部に対して電氣的に絶縁されたものである。

さらに、ボンディングワイヤ5は、チップ2上の外周部から中央部にかけての全面に自在に配置された複数のボンディングパッド3と、リードフレーム上の種々の位置に配列された複数のインナーリード4とを、それぞれ接続するものである。

【0048】

以上説明したように、本実施の形態 5 のように構成されたワイヤボンディング装置においては、ワイヤ全長 AL に対する比率を設定して複数の屈曲部 $K1 \sim K4$ を形成しているので、ワイヤ全長 AL の異なる複数のボンディングワイヤ 5 が混在する半導体装置であっても、各ボンディングワイヤ 5 の構造体を相似形にて形成できる。これにより、機械的強度の高いボンディングワイヤ 5 にて、ボンディングワイヤ 5 とチップ 2 との短絡を確実に防止しながら、ボンディングパッド 3 をチップ 2 上の任意の位置に配置可能としたので、チップ 2 内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

【 0 0 4 9 】

なお、本実施の形態 5 では、本発明を、ボンディングパッド 3 からインナーリード 4 への操作方向を設定したワイヤボンディング装置に適用したが、インナーリード 4 からボンディングパッド 3 への操作方向を設定したワイヤボンディング装置に対しても、本発明を適用することができる。その場合、本実施の形態 5 と同様の効果を奏することになる。

【 0 0 5 0 】

実施の形態 6.

以下、この発明の実施の形態 6 を図面に基づいて詳細に説明する。図 6 は、この発明の実施の形態 6 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。図 6 において、2 はチップ、3 はボンディングパッド、5 はボンディングワイヤを示す。

なお、図 6 において、ダイパッド、インナーリードは、簡単のため図示を省略する。

【 0 0 5 1 】

そして、不図示のワイヤボンディング装置により、ボンディングワイヤ 5 が、ボンディングパッド 3 からインナーリードへと接続される。

その際、前記実施の形態 5 と同様に、管部の階段状の移動により、ボンディングワイヤ 5 には、ボンディングパッド 3 側から、複数の屈曲部が順次形成される。このとき、屈曲部の位置ずれ量（補正量） ΔL に応じて、ボンディングワイヤ 5 のワイヤ全長が補正される。

【 0 0 5 2 】

詳しくは、屈曲部を形成するためのワイヤ全長に対する比率が、ワイヤ全長とともに、ワイヤボンディング装置の入力部に入力されている。そして、その設定値に基づいて、ワイヤボンディング装置の管部が、図中の矢印Mに示すように、階段状に移動する。これにより、ボンディングワイヤ5におけるチップ2側の端部を基準として、距離 L_1 の位置に屈曲部K1が形成されることになる。

【 0 0 5 3 】

ここで、管部が距離 L_1 に対して位置ずれ量 ΔL だけ大きく又は小さく移動したときに、その位置ずれ量 ΔL をワイヤボンディング装置の制御部にて保持（記憶）する。そして、屈曲部の位置ずれ量 ΔL の絶対値を、ワイヤ全長に加減する。例えば、当初設定されていたワイヤ全長を AL としたときに、調整後のワイヤ全長は $AL + \Delta L$ となる。これにより、最終的に形成されるボンディングワイヤ5のワイヤ全長は微調整されるので、当初設定されたボンディングワイヤ5の形状に対して、相似のボンディングワイヤ5を形成することができる。

【 0 0 5 4 】

以上説明したように、本実施の形態6のように構成されたワイヤボンディング装置においては、屈曲部を形成する際に位置ずれが発生しても、機械的強度の高いボンディングワイヤ5を安定的に供給して、ボンディングワイヤ5とチップ2との短絡を確実に防止しながら、ボンディングパッド3をチップ2上の任意の位置に配置可能としたので、チップ2内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

【 0 0 5 5 】

なお、本実施の形態6では、ボンディングワイヤ5のワイヤ全長の補正は、屈曲部K1の位置ずれ量 ΔL の絶対値をワイヤ全長に加減したものである。これに対して、屈曲部K1の位置ずれ量 ΔL をワイヤ全長（ AL ）に対する比率（ L_1 / AL ）で除した値（ $\Delta L \times AL / L_1$ ）をワイヤ全長に加減することで、ワイヤ全長の補正（ $AL \pm \Delta L \times AL / L_1$ ）を行うこともできる。その場合も、本実施の形態6と同様の効果を奏することになる。

【 0 0 5 6 】

実施の形態 7.

以下、この発明の実施の形態 7 を図面に基づいて詳細に説明する。図 7 (A) は、この発明の実施の形態 7 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略上面図であり、図 7 (B) はその概略正面図である。

同図において、1 はダイパッド、2 はチップ、3 はボンディングパッド、4 はインナーリード、5 はボンディングワイヤ、5 a はボンディングワイヤ 5 のチップ 2 側の端部、5 b はボンディングワイヤ 5 のインナーリード 4 側の端部、K 1 ~ K 4 はボンディングワイヤ 5 の屈曲部を示す。

【0057】

そして、不図示のワイヤボンディング装置により、ボンディングワイヤ 5 が、ボンディングパッド 3 からインナーリード 4 へと接続される。

その際、管部の階段状の移動により、ボンディングワイヤ 5 には、ボンディングパッド 3 側から、屈曲部 K 1、K 2、K 3、K 4 が順次形成される。

詳しくは、屈曲部 K 1 ~ K 4 を形成するために、まず、チップ 2 主面方向からみた、ボンディングパッド 3 からチップ 2 端面に至るチップ上ワイヤ長 C L を算出する。具体的には、チップ主面方向からみたチップ 2 の寸法 T D と、チップ主面方向からみたボンディングワイヤ 5 の両端 5 a、5 b の座標とから、チップ上ワイヤ長 C L を算出する。ただし、チップ 2 上におけるボンディングパッド 3 の位置、すなわち、チップ 2 上における端部 5 a の位置は、予め数値情報としてワイヤボンディング装置に入力されている。

【0058】

その後、チップ上ワイヤ長 C L の算出結果を、短絡を生じない屈曲部 K 1 ~ K 4 の位置を判断するためのデータとして、各屈曲部 K 1 ~ K 4 の位置を決定（自動設定）する。

そして、その自動設定値に基づいて、ワイヤボンディング装置の管部が移動して、各屈曲部 K 1 ~ K 4 がそれぞれ形成されることになる。

以上のように本実施の形態 7 のワイヤボンディング装置により形成された屈曲部 K 1 ~ K 4 は、いずれも、チップ 2 の表面 2 a から離れた位置に形成されて、チップ 2 上の導電部に対して電氣的に絶縁されたものである。

【 0 0 5 9 】

以上説明したように、本実施の形態 7 のように構成されたワイヤボンディング装置においては、チップ上ワイヤ長 CL を算出して、形成すべき屈曲部 $K1 \sim K4$ の位置を設定している。これによって、ボンディングワイヤ 5 とチップ 2 との短絡が確実に防止される機械的強度の高いボンディングワイヤ 5 の安定的な供給が可能となり、ボンディングパッド 3 をチップ 2 の表面に自由に配置して、チップ 2 内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

【 0 0 6 0 】

実施の形態 8.

以下、この発明の実施の形態 8 を図面に基づいて詳細に説明する。図 8 は、この発明の実施の形態 8 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。本実施の形態 8 は、チップ 2 の位置ずれを検出する検出部が設けられている点が、前記実施の形態 7 と相違する。

同図において、1 はダイパッド、2 はチップ、3 はボンディングパッド、4 はインナーリード、5 はボンディングワイヤ、10 はダイパッド 1 上のチップ 2 の位置ずれを検出する検出部を示す。

【 0 0 6 1 】

そして、不図示のワイヤボンディング装置により、前記実施の形態 7 と同様に、チップ上ワイヤ長 CL が算出された後に、ボンディングワイヤ 5 に複数の屈曲部 $K1 \sim K4$ が順次形成される。

ここで、チップ上ワイヤ長 CL の算出に際して、検出部 10 で検出したチップ 2 の位置ずれ量に基づいた計算の調整が行われる。すなわち、ダイパッド 1 に対するチップ 2 の位置ずれが生じると、チップ 2 上のボンディングパッド 3 と、リードフレーム上のインナーリード 4 との相対的な位置も変動する。したがって、正確なチップ 2 の位置を検出して、ボンディングワイヤ 5 の的確な接続を行う必要がある。具体的には、検出部 10 は、例えば、光学的な位置検出装置であって、この検出部 10 で、チップ 2 の端面の位置や、チップ 2 上のパターンの位置のずれを検出する。この位置ずれ量に基づきチップ上ワイヤ長 CL の算出結果の調整を行う。

【 0 0 6 2 】

その後、調整されたチップ上ワイヤ長CLの算出結果を、短絡を生じない屈曲部K1～K4の位置を判断するためのデータとして、各屈曲部K1～K4の位置を自動設定する。

そして、その自動設定値に基づいて、ワイヤボンディング装置の管部が移動して、各屈曲部K1～K4がそれぞれ形成されることになる。

以上のように本実施の形態8のワイヤボンディング装置により形成された屈曲部K1～K4は、いずれも、チップ2の表面2aから離れた位置に形成されて、チップ2上の導電部に対して電氣的に絶縁されたものである。

【 0 0 6 3 】

以上説明したように、本実施の形態8のように構成されたワイヤボンディング装置においては、精度の高いチップ上ワイヤ長CLを算出して、形成すべき屈曲部K1～K4の位置を設定している。これによって、ボンディングワイヤ5とチップ2との短絡が確実に防止される機械的強度の高いボンディングワイヤ5の安定的な供給が可能となり、ボンディングパッド3をチップ2の表面に自由に配置して、チップ2内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

【 0 0 6 4 】

実施の形態9.

以下、この発明の実施の形態9を図面に基づいて詳細に説明する。図9は、この発明の実施の形態9を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。本実施の形態9は、前記実施の形態6と前記実施の形態8とを組み合わせたものである。

同図において、1はダイパッド、2はチップ、3はボンディングパッド、4はインナーリード、5はボンディングワイヤ、10はダイパッド1上のチップ2の位置ずれを検出する検出部を示す。

【 0 0 6 5 】

本実施の形態9において、ボンディングワイヤ5は、以下のように形成される。まず、前記実施の形態8と同様に、検出部10でチップ2の位置ずれ量を検出

して、その検出結果に基づき調整されたチップ上ワイヤ長を算出する。その後、調整されたチップ上ワイヤ長の算出結果を、短絡を生じない屈曲部 K_n の位置を判断するためのデータとして、各屈曲部 K_n の位置を決定する。そして、その決定された設定値に基づいて、ワイヤボンディング装置の管部が移動して、各屈曲部 K_n がそれぞれ形成される。

このとき、屈曲部 K_n の位置ずれが生じた場合には、前記実施の形態 6 と同様に、その位置ずれ量に応じて、ボンディングワイヤ 5 のワイヤ全長が補正される。

【0066】

以上説明したように、本実施の形態 9 のように構成されたワイヤボンディング装置においては、屈曲部を形成する際に位置ずれが発生しても、ボンディングワイヤ 5 とチップ 2 との短絡が確実に防止される機械的強度の高いボンディングワイヤ 5 の安定的な供給が可能となり、ボンディングパッド 3 をチップ 2 上の任意の位置に配置して、チップ 2 内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

【0067】

実施の形態 10.

以下、この発明の実施の形態 10 を図面に基づいて詳細に説明する。図 10 は、この発明の実施の形態 10 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。本実施の形態 10 のワイヤボンディング装置は、予め定めた設定値とチップ上ワイヤ長とを比較した結果に基づいて、操作方向（ボンディング方向）を切換え可能に形成している点が、前記実施の形態 7 と相違する。

同図において、1 はダイパッド、2 はチップ、3 はボンディングパッド、4 はインナーリード、5 はボンディングワイヤを示す。

【0068】

以下、本実施の形態 10 のワイヤボンディング装置による、操作方向の切換えの手順を説明する。まず、ワイヤボンディング装置の制御部には、予めチップ上ワイヤ長に対する設定値（しきい値） S が入力される。そして、前記実施の形態

7と同様に、チップ2寸法等の数値情報に基づき、チップ上ワイヤ長を算出する。その後、算出されたチップ上ワイヤ長と、チップ上ワイヤ長の設定値Sとを対比して、その結果に基づいてボンディングワイヤ5の操作方向を決定する。

【0069】

例えば、n本目のボンディングワイヤ5については、ボンディングパッド3の位置がチップ2上の中央部にあるために、算出されたチップ上ワイヤ長が設定値Sより小さな値になったとする。この場合、n本目のボンディングワイヤ5は、ボンディングパッド3からインナーリード4に向けての順方向Bにボンディングされる。

これに対して、n+1本目のボンディングワイヤ5については、ボンディングパッド3の位置がチップ2上の外周部（対応するインナーリード4から離れた端面側である。）にあるために、算出されたチップ上ワイヤ長が設定値Sを超えた値になったとする。この場合、n+1本目のボンディングワイヤ5は、インナーリード4からボンディングパッド3に向けての逆方向RBにボンディングされる。

【0070】

このように、本実施の形態10では、計算された各チップ上ワイヤ長と、設定値Sとを対比して、その各結果に基づいて適宜操作方向を切換えて、複数のボンディングワイヤ5を形成する。

【0071】

以上説明したように、本実施の形態10のように構成されたワイヤボンディング装置においては、ボンディングワイヤ5とチップ2との短絡が確実に防止される機械的強度の高いボンディングワイヤ5の安定的な供給が可能となり、ボンディングパッド3をチップ2の表面に自由に配置して、チップ2内部の回路部におけるレイアウトの自由度を高くすることができる。

さらに、チップ上ワイヤ長の長短により、ボンディングワイヤ5の操作方向を切換え可能に形成しているため、ボンディングワイヤ5における屈曲部の形成が比較的容易な操作方向を選択することができる。

【0072】

なお、本発明が上記各実施の形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、各実施の形態の中で示唆した以外にも、各実施の形態は適宜変更され得ることは明らかである。また、上記構成部材の数、位置、形状等は上記実施の形態に限定されず、本発明を実施する上で好適な数、位置、形状等にすることができる。

【 0 0 7 3 】

【発明の効果】

本発明は以上のように構成されているので、ボンディングワイヤとチップとの短絡が確実に防止される機械的強度の高いボンディングワイヤの安定的な供給により、ボンディングパッドがチップ上の任意の位置に配置可能となり、チップ内部の回路部におけるレイアウトの自由度が高く、開発効率の高い半導体装置及びワイヤボンディング装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 この発明の実施の形態 1 を示す半導体装置の概略図である。

【図 2】 この発明の実施の形態 2 を示す半導体装置の概略図である。

【図 3】 この発明の実施の形態 3 を示す半導体装置の概略図である。

【図 4】 この発明の実施の形態 4 を示す半導体装置の概略図である。

【図 5】 この発明の実施の形態 5 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。

【図 6】 この発明の実施の形態 6 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。

【図 7】 この発明の実施の形態 7 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。

【図 8】 この発明の実施の形態 8 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。

【図 9】 この発明の実施の形態 9 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。

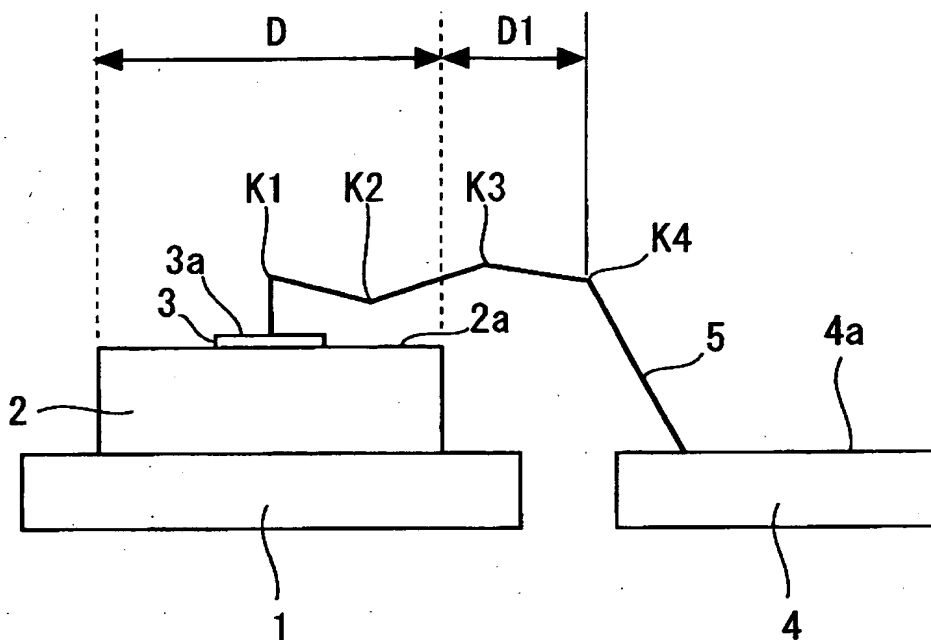
【図 1 0】 この発明の実施の形態 1 0 を示すワイヤボンディング装置により製造される半導体装置の概略図である。

【符号の説明】

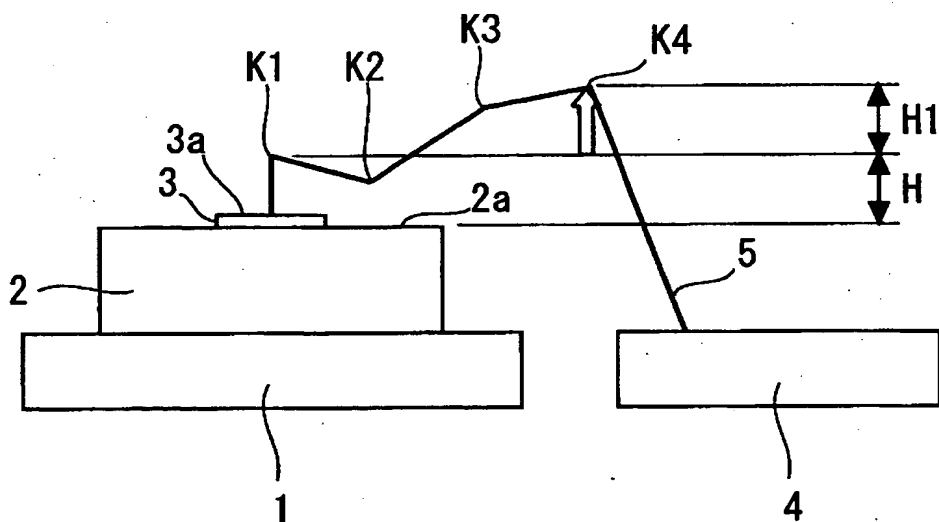
1 ダイパッド、 2 チップ、 2 a 表面（主面）、 3 ボンディング
パッド、 3 a 表面、 4 インナーリード、 4 a 表面、 5 ボンディ
ングワイヤ、 5 a、5 b 端部、 6 封止樹脂、 6 a 表面、 1 0 検
出部、 K 1 ~ K 4 屈曲部。

【書類名】 図面

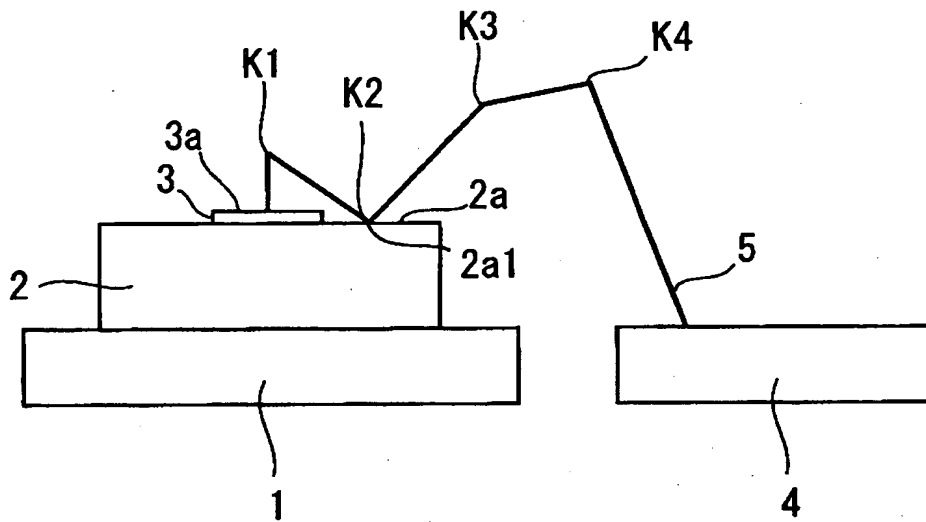
【図 1】



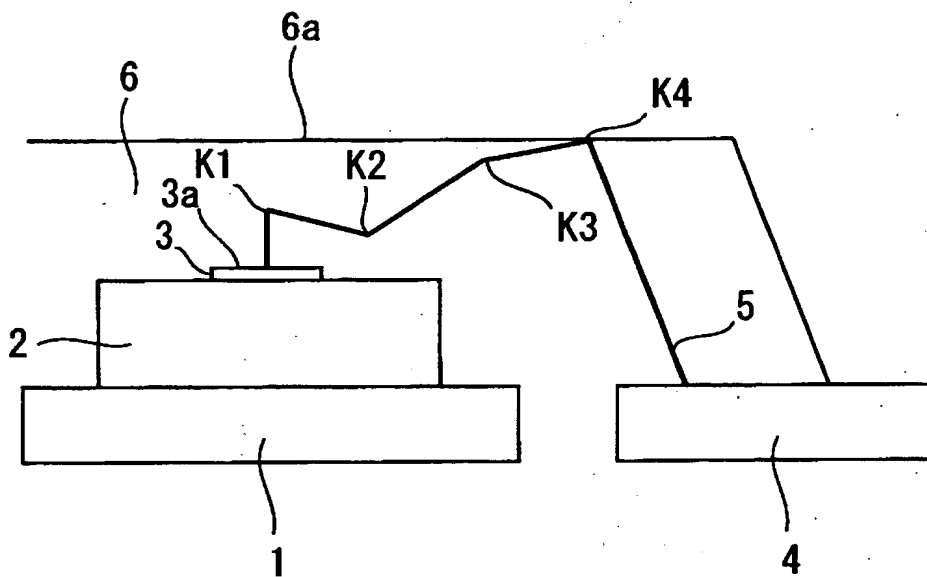
【図 2】



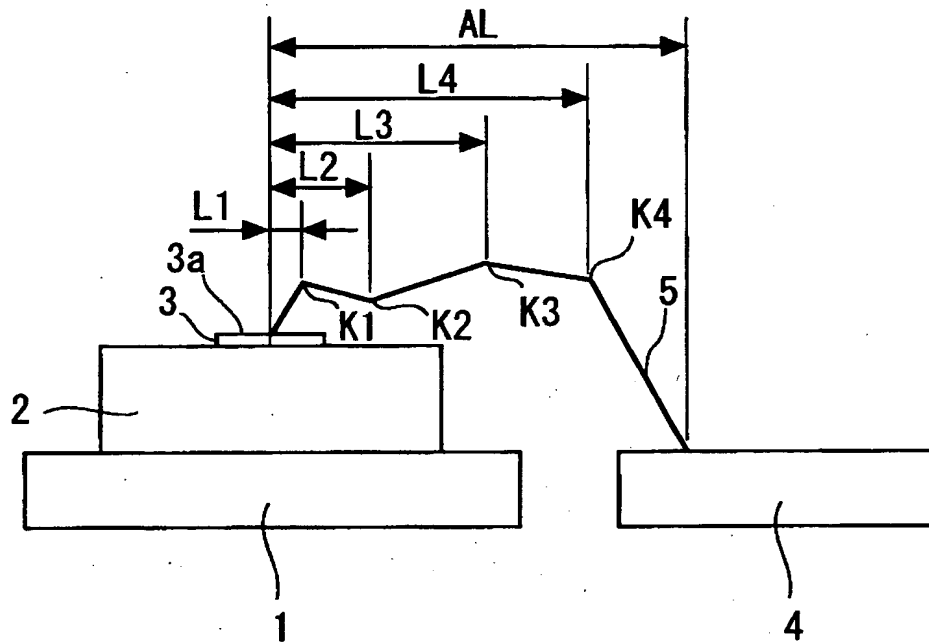
【図 3】



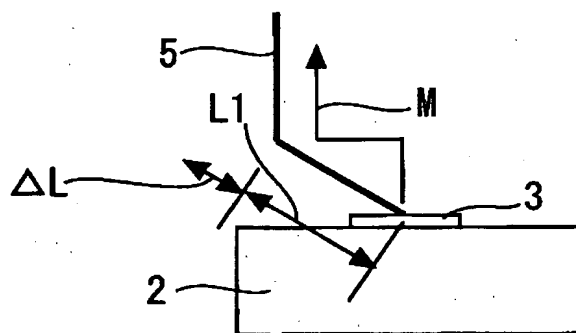
【図 4】



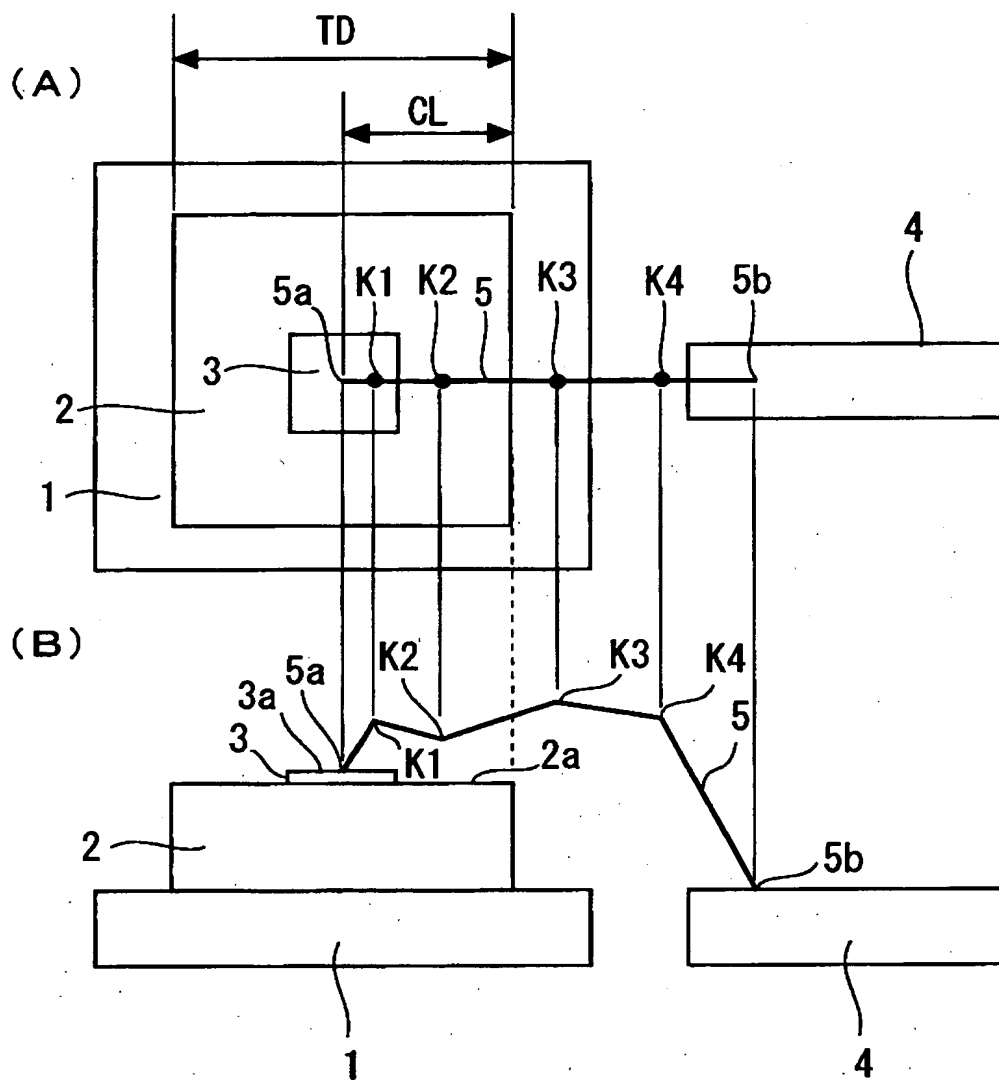
【図 5】



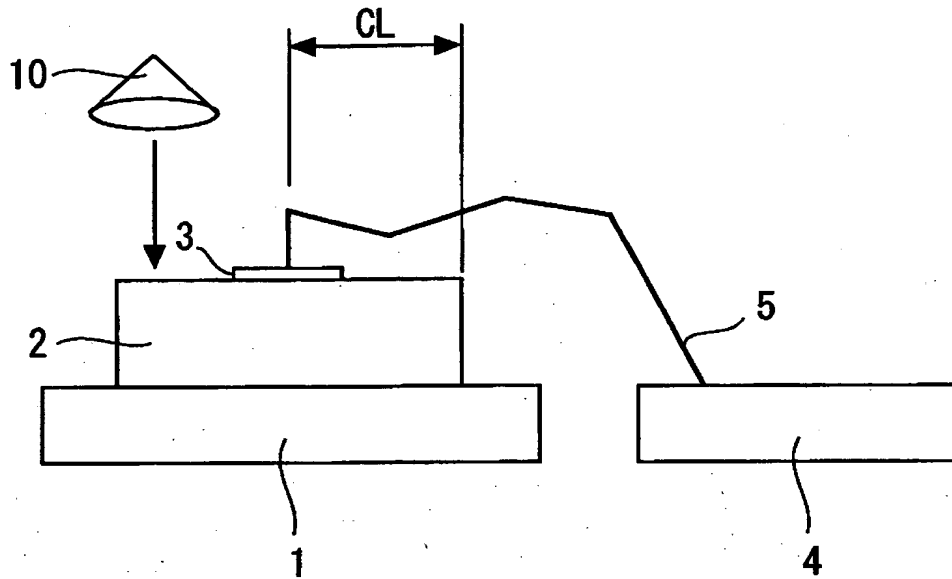
【図 6】



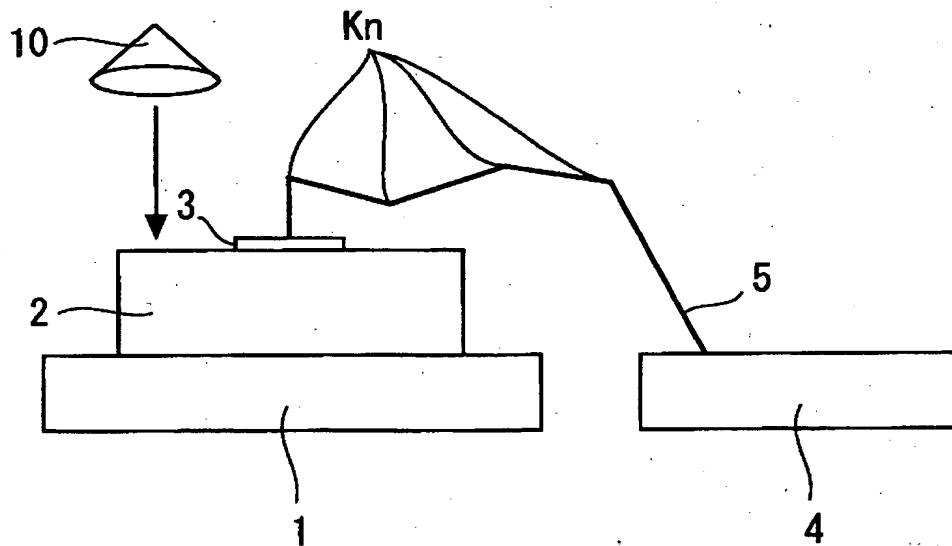
【図 7】



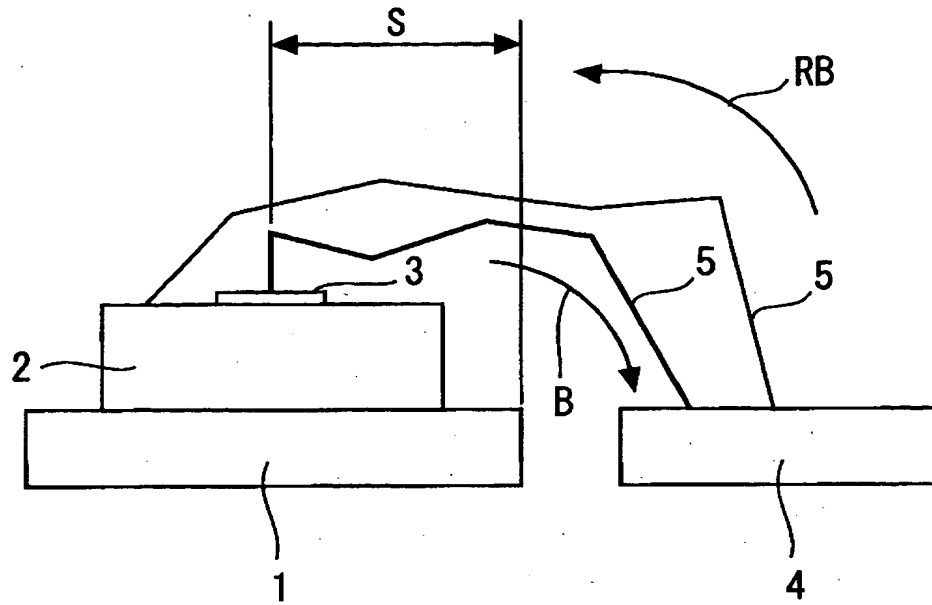
【図 8】



【図 9】



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 チップ内部の回路部のレイアウトの自由度が高くて、開発効率の高い半導体装置及びワイヤボンディング装置を提供する。

【解決手段】 チップ2上に配列された複数のボンディングパッド3と、ボンディングパッド3に対向して配列された複数のインナーリード4とが、それぞれボンディングワイヤ5にて電氣的に接続された半導体装置であって、ボンディングワイヤ5は、チップ2上の導電部に対して電氣的に絶縁された複数の屈曲部K1～K4を備えるとともに、ボンディングパッド3をチップ2上における外周部から中央部にかけての任意の位置に配置可能に形成されたものである。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006013]

1. 変更年月日	1990年 8月24日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号
氏 名	三菱電機株式会社